

トッパールチナSP/SV

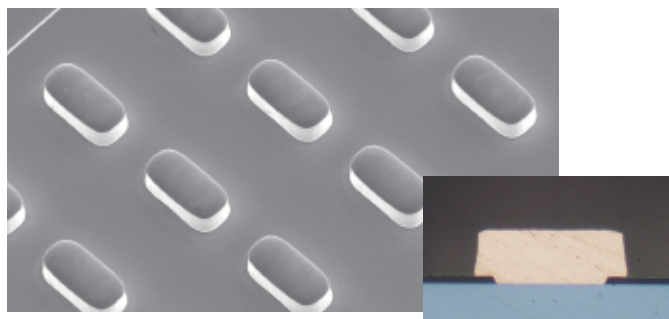
TOP LUCINA SP/SV

銅バンプ形成用

For copper bump formation

トッパールチナSP TOP LUCINA SP

- 高電流密度対応(5A/dm²)
For high current density
- 良好なパターン形状を実現
Can obtain fine bump shape
- 高い膜厚均一性で生産可能
Excellent in thickness uniformity for mass-production
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能
Quantitative analysis is possible for all additives



電流密度:5A/dm²
Current density

ピラー高さ:30 μm
Pillar height

フリップチップ実装用途だけでなく、
銅ピラーの高速形成にも対応

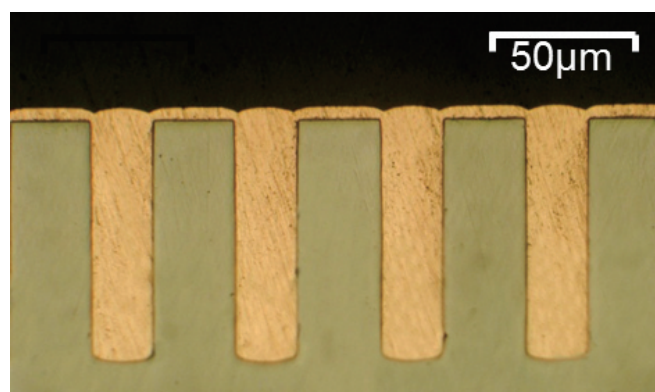
For flip-chip mounting and high-speed copper pillar formation

TSVフィリング用

For TSV filling

トッパールチナSV TOP LUCINA SV

- 高アスペクト比ビアのフィリングが可能
Via-filling for high aspect ratio can be realized
- 低膜厚で高アスペクトビアの充填を実現
Realize the filling into high-aspect-ratio via holes by small thickness
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能
Quantitative analysis is possible for all additives



TSV形成用途だけでなく、
高アスペクト比トレンチへの埋め込みにも対応

For TSV formation and high-aspect-ratio trench filling

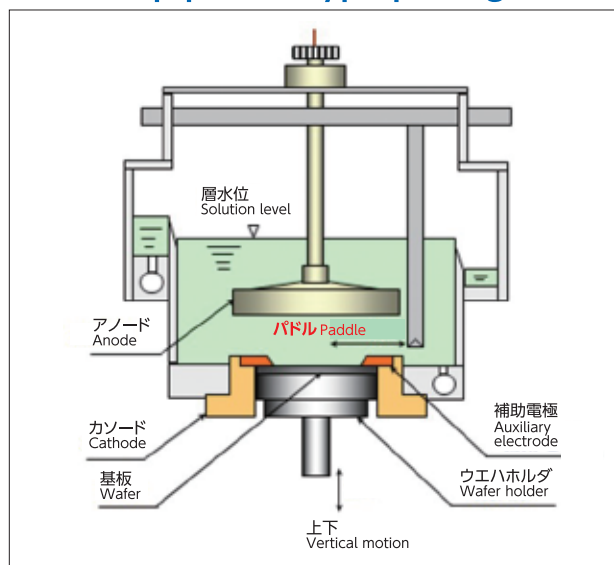
サポート体制

Support system

フェイスアップ式めっき装置で4~8インチの試作が可能

Prototype test for 4 to 8 inches of wafer can be performed by using the face-up paddle type plating system. (12インチ以上はご相談となります) (Please consult with us if wafer is over 12 inches.)

Face-up paddle type plating cell



株東設 フェイスアップ式半自動めっき装置
Face-up paddle type plating system made of Tosetz Inc.